

2026년 반도체 산업 전문인력 양성 교육 교육생 모집공고(10기)

용인시산업진흥원에서는 용인시 반도체 산업 실무역량 강화와 현장 전문인력 양성을 위한 반도체 이론 및 공정·장비 실습 교육을 운영하오니 관내 반도체 기업 재직자 및 예비 취·창업자분들의 많은 관심과 참여 바랍니다.

2026년 8월 19일
용인시산업진흥원장

1 모집개요

- **교 육 명:** 2026년 반도체 산업 전문인력 양성 교육
- **교육기간:** 2026. 4. ~ 2026. 10. ※ 매월 1~2회 운영, 회차별 커리큘럼 변동
 - 10기: 2026. 9. 21.(월) ~ 9. 23.(수) 09:00~18:00 (1일 8시간, 3일 교육)
- **교육내용:** 반도체 이론 및 공정·장비 실습(오프라인 교육)
 - 10기: 반도체장비 요소기술 및 패터닝 공정실습
- **교육장소:** 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 77 에이스광교타워3 B214호(반도체공정기술교육원)
- **교 육 비:** 10기 무료 * 65만원 상당 교육, 중식 무료제공
- **교육대상:** 10기 13명 내외 모집
 - 용인시 소재 반도체 기업 재직자
 - 용인시 반도체 기업 예비 취·창업자
 - 관내 대학 반도체 분야 전공자(졸업 또는 재학)
 - 타 지역 대학 반도체 분야 전공자(졸업 또는 재학) 중 용인시 거주자
 - 타 지역 거주 중인 반도체 분야 전공자(졸업 또는 재학) 중 용인 반도체 기업으로 취업을 준비 중인 자 ※ 용인시 반도체 기업 면접확인서, 용인시 일자리센터 구직 확인 서류 등 제출 必
 - 반도체 분야 예비 창업자(창업기업 소재지 용인)
 - 용인시 거주 중인 일반시민

○ 교육일정 및 교육과정(10기)

커리큘럼	반도체장비 요소기술 및 패터닝 공정실습 과정	교육시간	일 8시간 (3일)	10기																																																												
교육개요	반도체장비를 구성하는 주요 요소기술 및 부대설비에 대해 살펴보고, 반도체 소자 제작에 있어 가장 중요한 과정인 패턴 형성 공정을 실습하는 과정으로 Photolithography 및 Dry Etch 공정에 대한 이론 및 실습 교육을 통해 실무 내용을 익히는 과정																																																															
교육장비	노광기, 드라이에처, 오븐, 현미경, 스핀코터, 현상작업대, 핫플레이트, 습식 세정기, 박막두께측정기																																																															
교육일정	<table><tr><th>일차</th><th>교육 시간</th><th>실습 내용</th></tr><tr><td rowspan="9">1</td><td>1교시(9:00~10:00)</td><td>교육과정 소개, 교육생 자기소개, 팀구성</td></tr><tr><td>2교시(10:00 ~11:00)</td><td>진공 기술 (Vacuum Technology)</td></tr><tr><td>3교시(11:00 ~ 12:00)</td><td>가열장치 (Heater Techology)</td></tr><tr><td>12:00 ~ 13:00</td><td>Lunch Break</td></tr><tr><td>4교시(13:00 ~ 14:00)</td><td>플라즈마 기술 (Plasma Technology)</td></tr><tr><td>5교시(14:00 ~ 15:00)</td><td>유체역학 (Fluid Dynamics)</td></tr><tr><td>6교시 (15:00 ~ 16:00)</td><td>반도체 장비의 부대 장치</td></tr><tr><td>7교시 (16:00 ~ 17:00)</td><td>클린룸 안전교육 & Wafer Handling 실습</td></tr><tr><td>8교시 (17:00 ~ 18:00)</td><td>반도체 장비의 작동 실습</td></tr><tr><td rowspan="9">2</td><td>1교시 (9:00 ~ 10:00)</td><td>Photolithography Process (1)</td></tr><tr><td>2교시 (10:00 ~ 11:00)</td><td>Photolithography Process (2)</td></tr><tr><td>3교시 (11:00 ~ 12:00)</td><td>Photolithography Process (3)</td></tr><tr><td>12:00 ~ 13:00</td><td>Lunch Break</td></tr><tr><td>4교시 (13:00 ~ 14:00)</td><td>Wafer Handling 실습</td></tr><tr><td>5교시 (14:00 ~ 15:00)</td><td>PR Coating & Developing 실습</td></tr><tr><td>6교시 (15:00 ~ 16:00)</td><td>Exposure Time의 영향에 대한 실험</td></tr><tr><td>7교시 (16:00 ~ 17:00)</td><td>Develop Time의 영향에 대한 실험</td></tr><tr><td>8교시 (17:00 ~ 18:00)</td><td>ADI CD 측정</td></tr><tr><td rowspan="9">3</td><td>1교시 (9:00 ~ 10:00)</td><td>Dry Etch Process</td></tr><tr><td>2교시 (10:00 ~ 11:00)</td><td>Wet Etch Process</td></tr><tr><td>3교시 (11:00 ~ 12:00)</td><td>Dry Etch Process 실습</td></tr><tr><td>12:00 ~ 13:00</td><td>Lunch Break</td></tr><tr><td>4교시 (13:00 ~ 14:00)</td><td>Patterning Process 실습 (Etch)</td></tr><tr><td>5교시 (14:00 ~ 15:00)</td><td>PR Strip & ACI CD 측정</td></tr><tr><td>6교시 (15:00 ~ 16:00)</td><td>Data 정리 및 Discussion</td></tr><tr><td>7교시 (16:00 ~ 17:00)</td><td>Data 발표 및 공유</td></tr><tr><td>8교시 (17:00 ~ 18:00)</td><td>Data 리뷰 및 과정 정리</td></tr></table>				일차	교육 시간	실습 내용	1	1교시(9:00~10:00)	교육과정 소개, 교육생 자기소개, 팀구성	2교시(10:00 ~11:00)	진공 기술 (Vacuum Technology)	3교시(11:00 ~ 12:00)	가열장치 (Heater Techology)	12:00 ~ 13:00	Lunch Break	4교시(13:00 ~ 14:00)	플라즈마 기술 (Plasma Technology)	5교시(14:00 ~ 15:00)	유체역학 (Fluid Dynamics)	6교시 (15:00 ~ 16:00)	반도체 장비의 부대 장치	7교시 (16:00 ~ 17:00)	클린룸 안전교육 & Wafer Handling 실습	8교시 (17:00 ~ 18:00)	반도체 장비의 작동 실습	2	1교시 (9:00 ~ 10:00)	Photolithography Process (1)	2교시 (10:00 ~ 11:00)	Photolithography Process (2)	3교시 (11:00 ~ 12:00)	Photolithography Process (3)	12:00 ~ 13:00	Lunch Break	4교시 (13:00 ~ 14:00)	Wafer Handling 실습	5교시 (14:00 ~ 15:00)	PR Coating & Developing 실습	6교시 (15:00 ~ 16:00)	Exposure Time의 영향에 대한 실험	7교시 (16:00 ~ 17:00)	Develop Time의 영향에 대한 실험	8교시 (17:00 ~ 18:00)	ADI CD 측정	3	1교시 (9:00 ~ 10:00)	Dry Etch Process	2교시 (10:00 ~ 11:00)	Wet Etch Process	3교시 (11:00 ~ 12:00)	Dry Etch Process 실습	12:00 ~ 13:00	Lunch Break	4교시 (13:00 ~ 14:00)	Patterning Process 실습 (Etch)	5교시 (14:00 ~ 15:00)	PR Strip & ACI CD 측정	6교시 (15:00 ~ 16:00)	Data 정리 및 Discussion	7교시 (16:00 ~ 17:00)	Data 발표 및 공유	8교시 (17:00 ~ 18:00)	Data 리뷰 및 과정 정리
일차	교육 시간	실습 내용																																																														
1	1교시(9:00~10:00)	교육과정 소개, 교육생 자기소개, 팀구성																																																														
	2교시(10:00 ~11:00)	진공 기술 (Vacuum Technology)																																																														
	3교시(11:00 ~ 12:00)	가열장치 (Heater Techology)																																																														
	12:00 ~ 13:00	Lunch Break																																																														
	4교시(13:00 ~ 14:00)	플라즈마 기술 (Plasma Technology)																																																														
	5교시(14:00 ~ 15:00)	유체역학 (Fluid Dynamics)																																																														
	6교시 (15:00 ~ 16:00)	반도체 장비의 부대 장치																																																														
	7교시 (16:00 ~ 17:00)	클린룸 안전교육 & Wafer Handling 실습																																																														
	8교시 (17:00 ~ 18:00)	반도체 장비의 작동 실습																																																														
2	1교시 (9:00 ~ 10:00)	Photolithography Process (1)																																																														
	2교시 (10:00 ~ 11:00)	Photolithography Process (2)																																																														
	3교시 (11:00 ~ 12:00)	Photolithography Process (3)																																																														
	12:00 ~ 13:00	Lunch Break																																																														
	4교시 (13:00 ~ 14:00)	Wafer Handling 실습																																																														
	5교시 (14:00 ~ 15:00)	PR Coating & Developing 실습																																																														
	6교시 (15:00 ~ 16:00)	Exposure Time의 영향에 대한 실험																																																														
	7교시 (16:00 ~ 17:00)	Develop Time의 영향에 대한 실험																																																														
	8교시 (17:00 ~ 18:00)	ADI CD 측정																																																														
3	1교시 (9:00 ~ 10:00)	Dry Etch Process																																																														
	2교시 (10:00 ~ 11:00)	Wet Etch Process																																																														
	3교시 (11:00 ~ 12:00)	Dry Etch Process 실습																																																														
	12:00 ~ 13:00	Lunch Break																																																														
	4교시 (13:00 ~ 14:00)	Patterning Process 실습 (Etch)																																																														
	5교시 (14:00 ~ 15:00)	PR Strip & ACI CD 측정																																																														
	6교시 (15:00 ~ 16:00)	Data 정리 및 Discussion																																																														
	7교시 (16:00 ~ 17:00)	Data 발표 및 공유																																																														
	8교시 (17:00 ~ 18:00)	Data 리뷰 및 과정 정리																																																														
교육방법	교육방식	강의 및 팀단위 실습																																																														
	활용도구	반도체공정기술교육원 자체 제작 교재																																																														

- 수료기준: 전체 교육 과정의 80% 이상 참여시 수료증 발급
- 안내사항
 - 본 교육은 반도체 관련 이론 및 실습을 포함하여 직무능력 향상을 중점으로 운영되는 교육임
 - 본 교육은 교육생이 직접 희망 커리큘럼을 선택 및 신청하여 운영함
 - 본 교육은 실습 포함 3일 과정으로 업무 및 개인 일정을 충분히 고려한 후 신청 바라며, 사전 연락 없이 무단 불참 시 추후 교육 신청 제한 등 불이익이 발생할 수 있음
 - 신청서 정보를 허위로 기재하는 경우 민.형사상 손해배상 책임 및 처벌을 받을 수 있음
 - 신청자 현황에 따라 기수별 접수 및 교육 일정, 커리큘럼이 변경될 수 있음
 - 교육생 선정 여부는 신청서 검토 후 개별 안내 예정(이메일, 문자 등)
 - 2026년 교육 수료생은 타 기수 교육을 중복수강할 수 없음
 - 동 공고문에서 정하지 아니한 내용은 용인시산업진흥원 안내사항을 따름

3 교육신청(10기)

- 신청기간: 공고일로부터 ~ 9. 9.(수) 23:59까지
- 신청방법: 진흥원 홈페이지(<https://www.ypa.or.kr>) 교육안내 확인 및 구글폼 신청서(<https://forms.gle/fMPxywcLXKVFUtCi9>) 작성 후 제출

4 문의처

- 용인시산업진흥원 전략산업팀(031-323-5229, seo@ypa.or.kr)